



2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз. 47, 49, 51, 69 устанавливать до упора в плату.
5. Элементы поз.19 устанавливать на прокладку выполненную из отрезка ленты от чип-элементов.
6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
7. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.070.015.

1. \*Размеры для справок.

					АВАНТ БСП-ПИ 03v2 СБ					
2					Плата BSP-PI_03v2			Литера	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разраб.	Щеделькин М.В		05.12.13							
Пров	Вершинин А.С.									
Т.контр.					Сборочный чертеж			Лист	Листов 1	
Н.контр.	Назаренко А.Н.							ООО "Прософт-Системы"		
Утв.	Чирков А.Г.									

№	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
1	<b>Сборочный чертеж</b>				
	АВАНТ БСП-ПИ 03v2 rev.2				
	<u>ДЕТАЛИ</u>				
	-----				
5	<b>Плата печатная</b>				
	BSP-PI_03v2		1		
	<u>Диоды</u>				
7	BAT54S	SOT-23_3	2	VD1,VD2	
9	Светодиод KP-1608SGC зеленый				
	KINGBRIGHT	0603	2	VD3,VD4	
11	Сборка NUP2201MR6T1(G) 6B ON	TSOP_6	1	VD5	
	<u>Индуктивности</u>				
15	Дроссель LQH43CN100K03L 10мкГн				
	650мА MURATA	1812	1	L1	
17	Ферритовая бусина				
	BLM31PG601SN1 MURATA	1206	2	FB1,FB2	
19	Кварц КХ-3Н 16,0МГц GEYER	2 pins	1	ZQ1	низкие
21	Кнопка 3ESH9-15 MULTIMEC				
	(3FSH9 с толкателем 1S09-16.0				Толкатель
	(16mm) или 1S11-16.0,				устанавл. при
	5ESH965 с толкателем 1SS09-16.0)	SMD_4	9	SB1-SB9	настройке
	<u>Конденсаторы</u>				
25	Чип 0805 X7R 50В 0,1мкФ ±10%	0805	14	C1,C4-C7,C9-C11,C15-C20	
27	Чип 0805 NP0 100В 22пФ ±5%	0805	2	C2,C3	
29	Чип 1206 X7R 25В 10мкФ ±10%	1206	2	C8,C12	

5					<b>АВАНТ БСП-ПИ 03v2 СП</b>			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Щеблыкин М.В		05-12-13	<b>Плата БСП-ПИ 03v2</b>		Лит.	Лист
Провер.		Вершинин А.С.						Листов
								1
								3
Н.контр.		Назаренко А.Н.			<b>Спецификация</b>		ООО «Прософт-Системы»	
Утв.		Чирков А.Г.						

31	Чип 0805 X7R 50B 3600пФ ±5%	0805	1	C21	3600-5100пФ
	<u>Микросхемы</u>				
35	ATmega128-16AU ATMEL				
	(ATmega128A-AU(R) ATMEL)	TQPF_64	1	DD1	
37	IDTQS3257Q IDT (SN74CBT3257DBQ				
	TI, FST3257QSC FAIRCHILD)	SOIC_16	1	DD2	
39	TMP75AIDR (AID, AIDG4, AIDRG4) TI	SOIC_8	1	DD4	
41	ADuM4160BRWZ (-RL) AD	SOIC_16	1	DD5	
43	FT232RL FTDI	SOIC_28	1	DD6	
	<u>Разъемы</u>				
47	Вилка на плату IDC-20M	IDC_20	1	X1	2.54мм
49	Вилка на плату IDC-10M	IDC_10	3	X2-X4	2.54мм
51	Вертикальный TYCO-1734366-2				USB A розетка
	(хуже USBA-1V, USB A 06)	6 pins	1	X5	на плату
	<u>Резисторы</u>				
55	Чип 1206 00Ом ±5%	1206	1	R5	Не устанавли.
57	Чип 1206 4,7Ом ±5%	1206	1	R3	
59	Чип 1206 240Ом ±1%	1206	2	R24,R25	23-250м 1%
61	Чип 1206 1000Ом ±5%	1206	8	R6,R9-R11,R13,R14,R16,R18	
63	Чип 1206 3300Ом ±5%	1206	2	R20,R21	
65	Чип 1206 10кОм ±5%	1206	6	R1,R2,R7,R12,R19,R26	
67	Чип 1206 1МОм ±5%	1206	1	R27	
69	Подстроечный 3362P-1-103				
	10кОм ±10% BOURNS	3 pins	1	R4	
71	Чип сборка YC324 1000Ом ±5% YAGEO	1206x4	2	RR1,RR4	
73	Чип сборка YC324 10кОм ±5% YAGEO	1206x4	2	RR2,RR3	

					АВАНТ БСП-ПИ 03v2 СП	Лист
5						2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

77	Транзистор IRML2803 N-канальный				
	MOSFET IR	SOT-23_3	1	VT1	
79	Фильтр DLW21SN900SQ2 50VDC				
	330мА MURATA	0805_4	1	TV1	

**Лист регистрации ревизий СП**

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
1	вновь	12.03.13		
2	1,2	26.03.13	Поз.55 не устанавливать. Добавлена замена для поз 39. Поз.21 толкатель устанавливать при настройке.	
3	2	11.03.13	Элемент поз.69 заменен на аналог другого производителя. Поз. 31 можно устанавливать номиналом от 3600 до 5100пФ.	
4	1,2	17.10.13	Для поз.21 и 51 добавлены аналоги.	
5	1-3	05.12.13	Добавлена замена для поз.21 Немного изменено оформление СП.	

**Лист регистрации ревизий СБ**

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
1	вновь	12.03.13		
2	1	05.12.13	Изменено оформление.	

					<b>АВАНТ БСП-ПИ 03v2 СП</b>	<b>Лист 3</b>
5						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		